

公司代码：688200

公司简称：华峰测控

北京华峰测控技术股份有限公司
2024 年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。

2、 重大风险提示

无

3、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、 公司全体董事出席董事会会议。

5、 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

是 否

7、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经公司第三届董事会第九次会议决议，公司2024年年度利润分配方案拟定如下：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本（扣除公司回购专用账户的股份余额）为基数，向全体股东每10股派发现金红利7.50元（含税）。不送红股，不进行公积金转增股本。截止2024年12月31日，公司总股本135,439,427股，扣除公司回购专用账户中股份总数为176,100股后的股本135,263,327股为基数，以此计算合计拟派发现金红利101,447,495.25元（含税），占2024年度归属于母公司所有者的净利润的比率为30.38%，剩余未分配利润结转至下一年度。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

上述利润分配方案已由公司第三届董事会第九次会议审议通过，该方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。

8、 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

适用 不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	华峰测控	688200	无

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	孙镪	魏文渊
联系地址	北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼	北京市海淀区丰豪东路9号院5号楼
电话	010-63725652	010-63725652
传真	010-63725652	010-63725652
电子信箱	ir@accotest.com	ir@accotest.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和销售。产品主要用于模拟、数模混合、分立器件和功率模块等集成电路的测试，销售区域覆盖中国大陆、中国台湾、美国、欧洲、日本、韩国、东南亚和印度等全球半导体产业发达的国家和地区。

自成立以来，公司始终专注于半导体自动化测试系统领域，以自主研发的产品实现了模拟及混合信号类半导体自动化测试系统的进口替代，同时不断拓展在氮化镓、碳化硅以及 IGBT 等功率分立器件和功率模块类半导体测试领域的覆盖范围。

目前，公司已成长为国内领先、全球知名的半导体测试系统本土供应商，也是为数不多向国内外知名芯片设计公司、晶圆厂、IDM 和封测厂商供应半导体测试设备的中国企业。

主要产品：

产品类型	图示	应用领域
STS8200		主要应用于电源管理、信号链类、智能功率模块、第三代化合物半导体 GaN 类等模拟、混合和功率集成电路的测试
STS8300		主要应用于更高引脚数、更高性能、更多工位的电源管理类和混合信号集成电路测试
功率模块测试产品		为客户提供基于 STS8200 测试平台的 PIM 专用测试解决方案、针对用于大功率 IGBT/SiC 功率模块及 KGD 测试
STS8600		主要应用于大规模 SoC 芯片（高速数字电路、高性能混合电路、微波/射频电路、通讯接口电路、CPU 芯片等）的测试

2.2 主要经营模式

1、盈利模式

公司专业从事半导体自动化测试系统的研发、生产和销售，向集成电路设计、IDM、晶圆制

造、封装测试等领域客户提供优质高效的半导体自动化测试系统及配件，并获取收入和利润。报告期内，公司主营业务收入来源于半导体自动化测试系统和测试系统配件的销售。

2、研发模式

公司主要采用自主研发模式，建立了以基础实验室和研发部为核心的研发组织体系，基础实验室负责前沿技术追踪和研究，研发部负责从基础技术、产品技术和应用技术三个层次开展具体研发工作。研发过程分为项目立项、研发阶段、验证阶段和结项阶段四大阶段。

3、采购模式

公司的采购方式为直接向原厂采购和向原厂指定的代理商及其分销商采购。质量部同研发部、生产部、采购部根据《合格供方选择和评价准则》，结合采购项目技术标准和要求，通过同类项目不同供方所提交的相关资料，综合质量、价格、服务信息进行比较，确定合格供方的名单。采用协商定价的原则来确定最终的采购价格。目前，公司已与众多优秀供应商建立了长期稳定的合作关系，可在最大程度上保障原材料采购的稳定。

4、生产模式

按照产品特点及市场销售规律，公司采用“销售预测+订单”安排生产计划，并根据核心工序自主生产、成熟工序委托外协的方式组织生产，完成生产计划。

5、销售模式

根据下游市场需求和自身产品特点，公司采取“直销为主，经销为辅”的销售模式。直销模式下，公司主要通过商业谈判、招投标的方式获取订单。经销模式下，公司销售对象为境外贸易商，该等客户在半导体测试行业领域积累了较多的境外客户资源，拥有较为成熟的境外销售渠道，同时自身的技术水平和团队也能够为终端客户提供一定的技术支持服务。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司所属行业为“专用设备制造业”下的“半导体器件专用设备制造”，主营业务为半导体自动化测试系统的研发、生产和制造。

(1) 半导体测试设备行业的发展阶段

半导体测试设备主要包括测试机、探针台和分选机。测试机用于检测芯片功能和性能，探针台与分选机实现被测晶圆/芯片与测试机功能模块的连接。在半导体晶圆制造和封装测试中均需使用到测试设备。全球半导体测试设备行业在 2023 年经历了短暂回调后，于 2024 年进入复苏阶段。根据 SEMI 数据，2023 年全球半导体测试设备市场规模为 62.49 亿美元，较 2021 年的 78 亿美元有所下滑，主要受终端市场需求疲软及半导体资本支出放缓影响。但 2024 年市场迎来显著反弹，

预计全年增长 7.4%，2025 年将继续增长，市场规模有望突破 80 亿美元。

测试设备作为半导体制造的关键环节，其需求与晶圆产能扩张和先进制程技术紧密相关。2024 年，全球新建晶圆厂项目加速，尤其是高性能计算（HPC）和汽车芯片需求的激增，推动测试设备需求增长。此外，测试设备在半导体设备总价值中的占比稳定在 6%-7%，2023 年全球测试设备占半导体设备市场的 6.3%。

中国半导体测试设备市场呈现高速增长态势。根据 SEMI 数据，中国大陆测试设备销售规模从 2013 年的 2.88 亿美元增至 2023 年的 21.53 亿美元，年复合增长率达 23.78%。2024 年，受益于成熟制程产能扩张和国产替代政策，市场规模预计突破 25 亿美元，占全球比重进一步提升至 35%。

全球半导体测试设备市场长期被泰瑞达和爱德万等国际巨头垄断。以华峰测控为代表的国产测试设备供应商经过多年的发展，目前已经在模拟、数模混合、功率等测试领域实现了国产替代，但是在数字和存储测试领域，目前国外巨头依然占据了绝对的垄断地位。得益于近年来国内设计公司在 SoC 和存储领域的不断发展，国产测试设备公司也陆续在此类领域取得突破，华峰测控推出了面向 SoC 测试领域的新一代测试设备 STS8600，进一步拓展了公司的测试范围，打开了未来的成长空间。

（2）半导体测试设备行业的基本特点和主要技术门槛

公司所属的半导体测试设备行业是典型的技术密集和知识密集的高科技行业，涵盖多门学科的综合技术应用，包括计算机、自动化、通信、电子和微电子等，在核心技术研发上具有研发周期长、研发风险高和研发投入大等特点。同时，半导体测试设备行业面向的客户群体较为固定，这些企业往往已经与现有供应商建立了长期合作关系，新进入者难以获得足够的市场份额。同时，测试设备的研发和生产需要大量的资本投入，并且回报周期较长，这就对企业的资金链管理提出了较高的要求，新进入者可能因资金不足而难以维持日常运营。

随着半导体应用场景的不断丰富，半导体器件的不断迭代，半导体技术也在不断进步，半导体器件的集成度越来越高，被测器件对功率测试的要求增大，为了测试速度更快、更复杂，集成度更高的半导体产品，未来的半导体设备将向覆盖面更广、资源更丰富、可配置性更强，软硬件协同、从验证到设计的高效和易操作的方向发展。

（2）公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司是国内最早进入半导体测试设备行业的企业之一，深耕半导体测试三十多年，是国内领先的半导体测试设备本土供应商。

凭借产品的高性能、易操作和服务优势等特点，公司已在模拟及数模混合测试领域打破了国外厂商的垄断地位，在营收和品牌优势方面均已达到了国内领先水平。

STS8200 测试系统主要用于模拟和功率类芯片和模块的测试，其中，在模拟测试领域，公司的市占率居国内前列；得益于光伏和新能源汽车的爆发，相关的功率半导体产品的发展也突飞猛

进，经过多年的技术积累和迭代，公司在功率产品方面的测试技术不断成熟，获得了诸多海内外的优质客户，也将在未来的较长时间段内在功率测试领域占据重要地位。

STS8300 测试系统主要用于更高引脚数、更高性能、更多工位的电源管理类和混合信号集成电路测试。经过数年的研发和迭代，该测试系统已经获得了广大客户的认可，近两年开始批量装机。

STS8600 测试系统是公司研制的新一代 SoC 测试系统，目前正在进行客户的验证工作。该机型使用全新的软件架构和分布式多工位并行控制系统，拥有更多的测试通道数以及更高的测试频率，进一步完善了公司的产品线，拓宽了公司产品的可测试范围，为公司未来的长期发展提供了强大的助力。

目前公司为国内前三大半导体封测厂商模拟混合测试领域的主力测试设备供应商，并进入了国际封测市场供应商体系，在中国台湾、东南亚、日本、印度、韩国、欧洲、美国、南非和北非等国家和地区都有装机；公司对国内的设计公司和 IDM 企业保持全面覆盖，确保在未来长期的竞争中保持领先地位，同时跟国外的设计公司和 IDM 企业也长期保持良好的沟通，诸如意法半导体、安森美、安世半导体等均已成为公司客户；公司未来将持续提高在新器件，新应用方面的测试能力，获得更多客户的认可。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

半导体行业作为电子产业的基石，一直在科技进步中扮演着举足轻重的角色。随着时间的推移，半导体的发展趋势呈现出多样化和复杂化的特征，涉及技术、市场、政策等多个层面的交织变化。

在技术层面，半导体行业经历了从硅基材料到化合物半导体，再到新型半导体材料的演进。目前，第三代半导体如氮化镓（GaN）和碳化硅（SiC）正因其优异的性能而被广泛应用于新能源汽车、5G 通信等领域。而新兴的需求，如人工智能（AI）和物联网（IoT），也为半导体行业带来了新的发展机遇。

从市场角度来看，智能手机等传统市场的增速放缓，而新能源汽车、5G 通信等新兴市场的快速扩张，为半导体行业带来了新的增长点。此外，AI 的快速发展使得对高性能计算芯片的需求激增，这对半导体行业也是一个重要的推动力量。

政策方面，各国政府对半导体行业的重视程度不断提高，出台了一系列政策来支持行业发展，如中国的半导体产业政策旨在加强自主创新能力，减少对外部依赖。

综上所述，半导体行业在未来将继续保持快速发展的态势，但发展过程中的挑战也不容忽视。

技术革新、市场需求的变化、政策的支持和国际贸易局势等因素都将影响半导体的未来走向。公司将密切关注这些动态，以便更好地把握行业发展的脉络。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2024年	2023年	本年比上年 增减(%)	2022年
总资产	3,808,080,455.23	3,466,864,543.70	9.84	3,371,356,514.42
归属于上市公司股东的净资产	3,570,280,795.20	3,332,493,963.13	7.14	3,138,951,327.13
营业收入	905,345,386.04	690,861,889.19	31.05	1,070,558,398.13
归属于上市公司股东的净利润	333,914,849.96	251,652,296.29	32.69	526,290,389.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	340,047,435.55	253,108,581.47	34.35	505,496,986.84
经营活动产生的现金流量净额	188,097,262.71	321,486,064.70	-41.49	393,832,444.38
加权平均净资产收益率(%)	9.69	7.80	增加1.89个百分点	18.47
基本每股收益(元/股)	2.47	1.86	32.80	3.91
稀释每股收益(元/股)	2.47	1.86	32.80	3.90
研发投入占营业收入的比例(%)	19.04	19.10	减少0.06个百分点	11.00

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	136,823,208.53	242,250,092.65	242,125,327.92	284,146,756.94
归属于上市公司股东的净利润	23,438,331.42	89,051,824.27	100,603,501.52	120,821,192.75
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	31,829,980.34	95,179,258.15	96,241,784.36	116,796,412.70
经营活动产生的现金流量净额	-8,028,380.20	23,710,352.49	1,828,460.56	170,586,829.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

适用 不适用

4、 股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	10,692						
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	7,314						
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0						
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数(户)	0						
前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称 (全称)	报告期内 增减	期末持股数 量	比例 (%)	持有 有限 条件 股 份 数 量	质押、标 记或冻结 情况		股东 性质
					股 份 状 态	数 量	
天津芯华投资控股有限公司	0	37,236,420	27.49	0	无	0	境内非国有法人
中国时代远望科技有限公司	0	20,085,225	14.83	0	无	0	国有法人
香港中央结算有限公司	108,569	6,766,772	5.00	0	无	0	其他
深圳芯瑞创业投资合伙企业(有限合伙)	-400,000	6,339,150	4.68	0	无	0	境内非国有法人
王皓	-39,720	3,712,108	2.74	0	无	0	境内自然人
李寅	-21,965	3,352,035	2.47	0	无	0	境内自然人
唐桂琴	-186,082	1,783,296	1.32	0	无	0	境内自然人
中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	997,709	1,745,487	1.29	0	无	0	其他
陈爱华	0	1,502,496	1.11	0	无	0	境内自然人
全国社保基金四一八组合	1,447,467	1,447,467	1.07	0	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	无						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无						

存托凭证持有人情况

□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

√适用 □不适用

单位:股

序号	股东名称	持股数量		表决权数量	表决权比例	报告期内表决权增减	表决权受到限制的情况
		普通股	特别表决权股份				
1	天津芯华投资控股有限公司	37,236,420	0	37,236,420	27.49	0	无
2	中国时代远望科技有限公司	20,085,225	0	20,085,225	14.83	0	无
3	香港中央结算有限公司	6,766,772	0	6,766,772	5.00	108,569	无
4	深圳芯瑞创业投资合伙企业（有限合伙）	6,339,150	0	6,339,150	4.68	-400,000	无
5	王皓	3,712,108	0	3,712,108	2.74	-39,720	无
6	李寅	3,352,035	0	3,352,035	2.47	-21,965	无
7	唐桂琴	1,783,296	0	1,783,296	1.32	-186,082	无
8	中信证券股份有限公司—嘉实上证科创板芯片交易型开放式指数证券投资基金	1,745,487	0	1,745,487	1.29	997,709	无
9	陈爱华	1,502,496	0	1,502,496	1.11	0	无
10	全国社保基金四一八组合	1,447,467	0	1,447,467	1.07	1,447,467	无
合计	/	83,970,456	0	83,970,456	/	/	/

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内，公司实现营业收入 905,345,386.04 元，比去年同期增长 31.05%；归属于上市公司股东的净利润 333,914,849.96 元，比去年同期增长 32.69%。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

适用 不适用